

# 东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

## (2024年9月30日)

证券代码：东芯股份

证券简称：688110

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	兴业证券、汇丰晋信基金、易方达基金、美林亚太有限公司
活动时间	2024年9月25日、9月26日
活动地点	公司会议室、策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幪 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期经营情况介绍</p> <p>公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司半年度的经营情况。</p> <p>二、交流的主要问题及答复</p> <p>1、晶圆代工厂的稼动率和下半年代工价格的展望如何？ 答：晶圆厂不同工艺节点的稼动率不一样。从我们使用的工艺节点来看，SLCNAND的整体产能利用率还是比较高的。从目前看下半年的代工价格不会有太大变化，公司将持续保持和代工厂的良好合作关系，实现上下游合作共赢，为公司业务发展提供供应链保障。</p> <p>2、下半年消费电子的需求公司如何看待？ 答：消费电子的需求旺季一般在每年的二季度和三季度，伴随上半年部分消费电子产品需求复苏以及终端客户囤货的影响，下半年需求较为平稳，消费电子板块订单能见度相对较低，我们会持续关注市场需求的变化，积极调整销售策略。</p> <p>3、公司的存、算、联一体化布局具体是如何规划？ 答：公司将继续以“提供可靠高效的存储产品及设计方案”为使命，专注于存储芯片设计领域的科技创新，继续保持高水平的研发投入，不断</p>

	<p>推陈出新，及时迭代提升产品关键性能，不断满足客户对高性能存储器芯片的需求，为日益发展的存储需求提供可靠高效的解决方案。同时，凭借多年来在行业内的资源、客户、供应链、经验等方面积累的优势，公司将以存储产品为核心，拓展智能化外延，向“存、算、联”一体化领域进行技术探索，以期为客户提供更多样化的芯片解决方案。今年，公司在无线通信芯片设计领域新设立了子公司亿芯通感，从事 Wi-Fi7 芯片的设计研发；在 GPU 领域对外投资了上海砺算，主要从事多层次（可扩展）图形渲染的芯片设计研发。公司将继续以存储为核心，寻求多元化的发展机遇，带动公司业务的增长。</p> <p>4、存储产品线未来发展规划？  答：关于 SLC NAND Flash，公司会保持在该产品线的优势，不断增加产品料号，推进产品制程更迭，不断提升产品市占率。关于 NOR Flash，公司积极推进 55nm 产线的中高容量产品的推出，努力提升市场份额。关于 DRAM，公司将继续推进 LPDDR4x 产品进度和客户导入工作，同时继续开发标准的 DDR 产品。公司的 MCP 产品稳步发展，并将继续进行方案组合的升级迭代，并努力提高车规 MCP 的营收占比。</p> <p>5、公司的 SLC NAND 产品有哪些优势？  答：公司 NAND Flash 产品核心技术优势明显，尤其是 SPI NAND Flash，该产品可提供 3.3V/1.8V 两种电压，具备 WSON、BGA 多种封装形式，公司采用了业内领先的单颗集成技术，将存储阵列、ECC 模块与接口模块统一集成在同一芯片内，有效节约了芯片面积，降低了产品成本，提高了公司产品的市场竞争力。</p>
日期	2024 年 9 月 30 日